

FC/FFP ZE/80 B BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



OMNIMATE® 보드 투 보드(Board-to-Board) 커넥터  
컴팩트한 장치의 유연한 엔지니어링  
미래 대비형 컨택트 시스템의 사용과 제조 공정의 최적화는  
효율적인 산업용 장치의 개발, 특히 Industry 4.0 분야에서  
그 중요성이 날로 커지고 있습니다. OMNIMATE® 보드  
투 보드 커넥터는 피치 1.27mm로, 각기 다른 설계에 대해  
최대한의 유연성을 제공합니다.

- 유연한 장치 설계 - 산업 용도로 적합한 밀도와 고도의 유연성을 가진 결선 조합의 만남 (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-to-Board)
- 자동화 준비 완료 - 고정밀 핀 동일평면성 및 SMT 고정 기능을 갖춘 자동 조립 용도로 개발
- 신뢰도 높은 접점 - 산업용 적합 금도금(PdNi-Au)을 적용해 체결 주기 최대 500회
- 공정 준비 완료 - 리플로우 솔더링을 위한 고성능 LCP 소재
- 확장성 - 높이가 각기 다르고 고접점 중첩이 있어 12~80개 풀까지 다양한 솔루션을 보장합니다.
- 활용도 높은 소형화 - 경사 또는 오프셋 등, 까다로운 체결 조건에서도 간편하고 안전한 결선 가능.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 피치(mm)(P): 1.27 mm, 극 수: 80, 90°, 180°, 270°, 박스
주문 번호	<a href="#">2853190000</a>
유형	FC/FFP ZE/80 B BX
GTIN (EAN)	4064675476047
수량	50 items
제품 데이터	UL:
패키징	박스

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	6.3 mm	깊이 (인치)	0.248 inch
높이	9.9 mm	높이 (인치)	0.3898 inch
너비	54.3 mm	폭 (인치)	2.1378 inch
순중량	1.1 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

자재 데이터

절연재	LCP	컬러 코드	검정
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 가연성 등급	V-0	접점 재질	구리 합금
보관 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
작동 온도, 최소	-55 °C	작동 온도, 최대	125 °C

패키징

패키징	박스	VPE 길이	121.00 mm
VPE 폭	81.00 mm	VPE 높이	32.00 mm

중요 참고 사항

IPC 준수	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.
--------	--

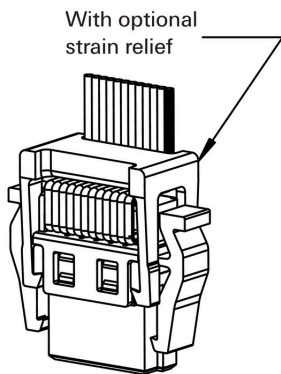
참고 사항

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-46-04-02
ECLASS 15.0	27-46-04-02		



With optional strain relief



Assembly of strain relief